



특허청구의 범위

1. 자성막과 절연막이 순차적으로 적층된 다층자성층과 이 다층자성층을 보호하는 비자성기판으로 각각 이루어지고, 일측 접착면에 자기갭과 코일권선홈이 형성된 한쌍의 코어반체를 구비하여 된 자기헤드에 있어서, 상기 일측 코어반체에 형성된 자기갭 및 코일권선홈의 내면과, 이와 대응되는 타측 코어반체의 접착면에, 이들의 접착시 내부 폐자로를 구성하여 자기갭 부위의 포화를 완화시키는 고평화자속밀도를 가지는 금속막이 각각 형성된 것을 특징으로 하는 자기헤드.

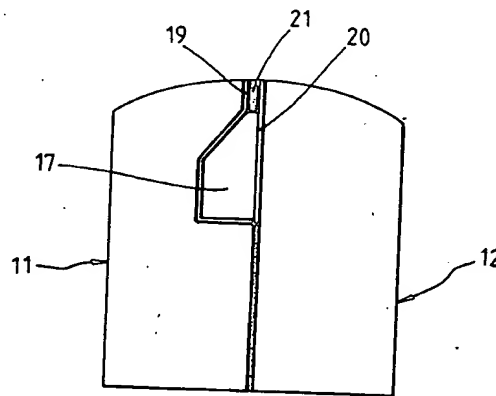
2. 비자성기판과 다층자성층이 복수층 적층된 코어블록을 소정의 패턴으로 절단하여 복수개의 코어반체블록을 형성하는 공정과, 상기 코어반체블록을 한쌍씩 나누고 한쌍씩 나누어진 코어반체블록 중 일측코어반체블록에 코일구멍선홈과 자기갭을 가공하는 공정과, 코일권선홈과 자기갭이 형성된 일측 코어반체블록을 타측 코어반체블록에 접착제로 접착시키는 공정과, 이를 소정패턴으로 절재하여 접착된 한쌍의 코어반체를 복수개 형성하는 공정을 포함하여 된 자기헤드의 제조방법에 있어서, 상기 일측 코어반체블록에 자기갭과 코일권선홈을 형성하는 공정과, 코어반체블록을 접착시키는 공정 사이에, 일측 코어반체블록에 형성된 자기갭 및 코일권선홈 내면과 이에 대응되는 타측 코어반체블록의 접착면에 이들의 접착시 내부 폐자로를 구성하는 고평화자속밀도를 가지는 금속막을 각각 형성하는 공정을 포함시켜 된 것을 특징으로 하는 자기헤드 제조방법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면의 간단한 설명

제3도는 제2도의 결합 정면도, 제4도 (가) 내지 (바)는 본 발명에 따른 자기헤드의 제조방법을 예시한 공정도.

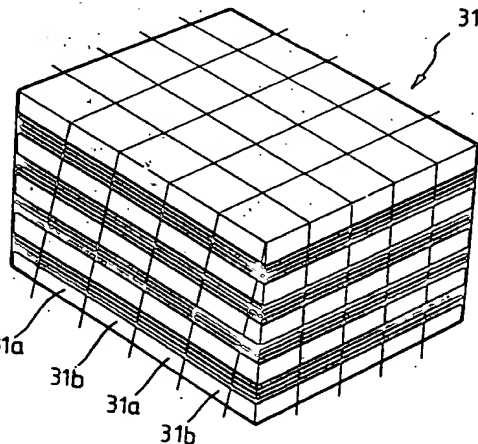
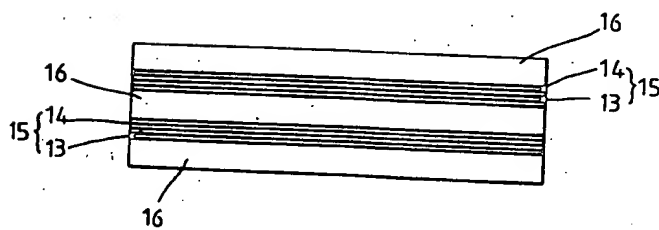
도 3



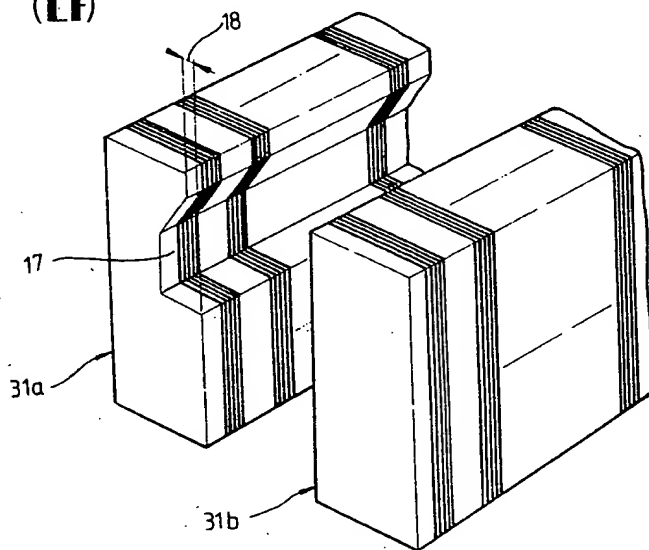
도 4

(가)

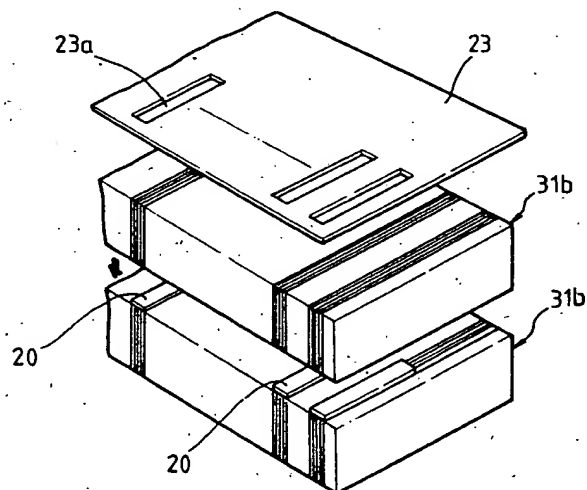
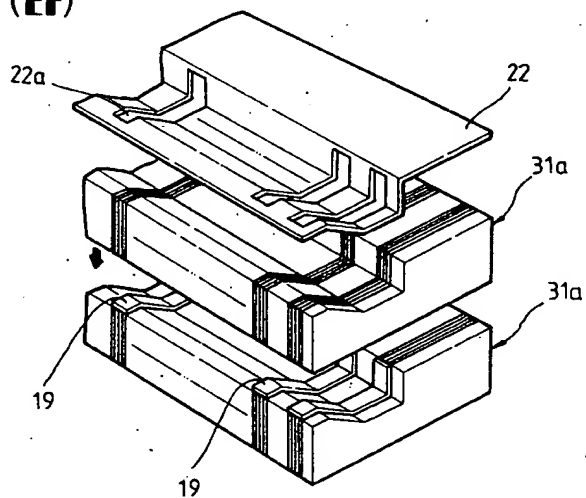
(나)



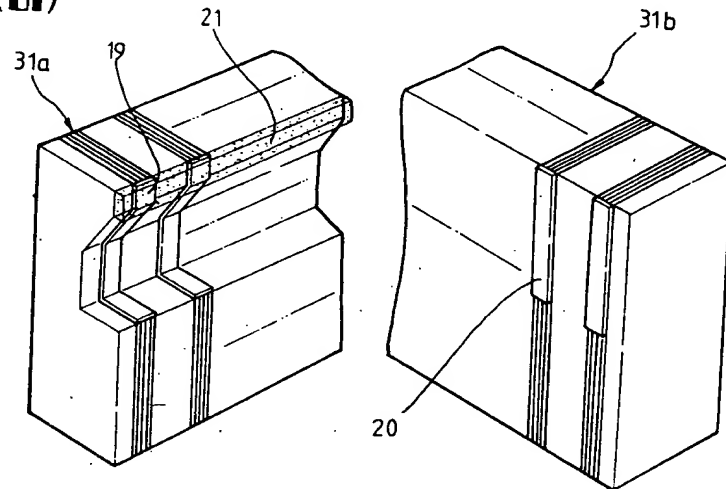
(E)



(F)



(D)



(E)

